

モバイル機器向け低消費電力SRAM

Low Power SRAM Family for Mobile Application

モバイル機器の要求に応える東芝低消費電力SRAM

- 16M SRAM・32M擬似SRAMをラインアップ
- 低電圧化に加速
(電源電圧 1.8Vをサポート)
- 小型化パッケージ(CSP)をサポート

■パッケージ



■モバイル機器向け低消費電力SRAMラインアップ

容量 (bit)	構成	プロセス	形名	アクセスタイム (ns)	電源電圧 (V)	ピン数	パッケージ幅 (inch)	
4M	512k × 8	E/R type	TC554001AF/AFT-70/-85/-10	70/85/100	5.0 ± 10%	32	SOP 0.525 TSOP-II 0.4	
			TC554001AF/AFT-70L/-85L/-10L	70/85/100				
			TC554001AF/AFT-70V/-85V/-10V	120/150/150				
		Full CMOS type	TC55V040AFT-55/-70	55/70	2.7 ~ 3.6	40	TSOP-I 10 × 14 mm	
			TC55V4000ST-70/-85	70/85		32	TSOP-I 8 × 13.4 mm	
			TC554161AFT-70/-85/-10	70/85/100		5.0 ± 10%	54	TSOP-II 0.4
	TC554161AFT-70L/-85L/-10L	70/85/100						
	TC554161AFT-70V/-85V/-10V	150	2.7 ~ 5.5					
	8M	512k × 16 1M × 8	E/R type	TC55V400AFT-55/-70	55/70	2.7 ~ 3.6	48	TSOP-I 12 × 14 mm
				* TC55W400XB5/7	55/70			2.7 ~ 3.3
* TC55Y400XB7/8				70/85	1.8 ~ 2.2			TSOP-I 12 × 20 mm
512k × 16		Full CMOS type	TC55W800FT-55/-70	55/70	2.7 ~ 3.3	48	FBGA 8 × 11 mm	
			★ TC55W800XB7/8	70/85			1.8 ~ 2.2	TSOP-I 12 × 20 mm
			* TC55Y800XB7/8	70/85				8 × 11 mm
16M	1M × 16 2M × 8	Full CMOS type	★ TC55W1600FT-55/-70	55/70	2.7 ~ 3.1	48	TSOP-I 12 × 20 mm	
	1M × 16		★ TC55W1600XB7/8	70/85			FBGA 10 × 12 mm	

★: 新製品 * : 開発中

■擬似スタティックRAMラインアップ

容量 (bit)	構成	形名	機能	アクセスタイム最大 (ns)	サイクルタイム最小 (ns)	電源電圧 (V)	ピン数	パッケージ幅 (inch)
32M	2M × 16	★ TC51W3216XB	/CE 同期タイプ	80	100	2.5 ~ 3.1	48	FBGA 9 × 6 mm
		★ TC51W3217XB	/OE・/WE 同期タイプ					
64M	4M × 16	* TC51W6416XB	/CE 同期タイプ	80	100	2.5 ~ 3.1	48	FBGA 9 × 6 mm
		* TC51W6417XB	/OE・/WE 同期タイプ					

★: 新製品 * : 開発中